

证券代码：300223

证券简称：北京君正

公告编号：2024-010

# 北京君正集成电路股份有限公司

## 2023 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 481,569,911 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	北京君正	股票代码	300223
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张敏	白洁	
办公地址	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼一层 A101-A113	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼一层 A101-A113	
传真	010-56345001	010-56345001	
电话	010-56345005	010-56345005	
电子信箱	investors@ingenic.com	investors@ingenic.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

公司为集成电路设计企业，主要从事集成电路芯片产品的研发与销售等业务，公司主要产品线包括计算芯片、存储芯片、模拟与互联芯片，产品被广泛应用于汽车电子、工业与医疗、通讯设备及消费电子等领域。

近几年来，集成电路产业发生了较大变化，消费类市场、汽车工业等行业类市场自 2021 年需求爆发性增长后，先后面临需求萎缩、库存高企等情形。由于消费类市场自 2021 年底陆续进入下调周期，2023 年部分消费市场已呈现回暖趋势。公司计算芯片所面向的部分消费类细分市场呈复苏趋势，公司不断夯实存量市场，及时把握市场新需求，推动计算芯片产品线销售收入的提升，2023 年度公司计算芯片销售收入实现了较好的同比增长。汽车、工业等部分行业市场自 2022 年第四季度进入下调周期，其主要的下调阶段在 2023 年，受此影响，2023 年公司面向行业市场的产品线存储芯片和模拟与互联芯片产品线销售收入均出现同比下降。

由于公司大部分业务来自汽车、工业医疗等行业市场，报告期内，鉴于行业市场需求较为低迷，产业链库存压力进一步影响了客户的采购需求，公司面向行业市场的产品销售收入同比下降，从而使公司总体营业收入和净利润同比下降，公司实现营业收入 453,092.57 万元，同比下降 16.28%，实现归属于上市公司股东的净利润 53,725.44 万元，同比下降

31.93%。公司因收购产生的存货、固定资产和无形资产等资产评估增值，其折旧与摊销等对公司报告期损益的影响金额为 4,317 万元，该资产增值摊销与公司经营情况关联关系较小，对公司现金流亦不造成影响。

### （1）经营模式

公司自成立以来一直采用 Fabless 的经营模式，在业务上专注于技术与产品的设计、研发，产品生产环节均委托大型专业集成电路委托加工商进行，具体包括晶圆的生产、测试和芯片的封装、测试等。公司产品主要面向电子信息行业的企业客户，客户采用公司的芯片后，需进行终端产品设计方案的研发。在销售模式上，公司采用直销和经销相结合的方式，其中对于重点客户，无论是通过直销还是经销的方式，公司均会直接对其提供技术支持与服务，协助客户解决产品开发过程中的技术问题。针对产品功能相近、市场量大的垂直市场，公司还会提供“Turnkey”的整体解决方案。

### （2）产品类别及应用

公司芯片产品所属领域涵盖了处理器、存储器和模拟电路等，具体产品类别分为计算芯片、存储芯片、模拟芯片和互联芯片，其中计算芯片的现有产品采用了 MIPS 架构，同时，随着 RISC-V 架构的发展，公司也在积极布局 RISC-V 相关技术的研发，公司自研的 RISC-V CPU 核已应用于部分芯片产品中。

从市场应用上，公司的芯片产品主要面向汽车、工业与医疗、通讯和消费等几大市场领域，其中计算芯片产品线主要应用于生物识别、二维码识别、商业设备、智能家居、智能穿戴、教育电子等智能硬件产品领域和安防监控、智能门铃、人脸识别设备等智能视觉相关领域；存储芯片主要产品有高集成密度、高性能品质、高经济价值的 SRAM、DRAM、Flash 等，主要面向汽车、工业医疗等行业市场；模拟芯片与互联芯片产品线包括各类 LED 驱动、DC/DC、GreenPHY、以及 G.vn、LIN、CAN 等芯片产品，可提供面向汽车领域、工规领域、家居家电及消费领域等多种型号的产品。

### （3）下一报告期内下游应用领域的宏观需求分析

近几年来，全球经济形势的波动直接影响着电子市场的需求变动，从而带来集成电路市场景气度的大幅波动。2023 年，部分消费类市场需求回暖，库存去化趋势良好，推动了市场需求的进一步复苏，使部分消费类市场呈现出良性需求发展趋势，预计 2024 年随着产业链库存的进一步去化，更多消费类市场领域将进入上行通道，市场有望逐渐进入良性发展阶段。

汽车、工业等行业类市场 2023 年需求低迷，产能过剩、产业链库存压力等情况也进一步影响了行业市场的客户需求，从而导致面向行业市场的芯片产品市场销售承压。2024 年，随着行业市场产业链各环节产品库存的逐渐去化，以及全球经济的逐渐复苏，预计行业市场需求有望在 2024 年逐步回暖。

尽管近两年来集成电路市场面临一定的增长压力，从长期来看，随着科学技术的不断进步，技术迭代将不断推动着芯片行业的高速发展，人工智能、大数据、5G、物联网等底层技术的不断成熟与发展将驱动下游细分领域电动化、智能化的不断升级，自动驾驶、数据中心、工业自动化、人工智能、物联网、元宇宙等领域持续发展，推动着汽车、工业、

通讯及消费电子市场的行业升级与转型，从而不断扩大市场对集成电路产品的总需求量，成为集成电路产业长期增长的重要驱动力。

#### (4) 行业竞争情况

公司产品包括了处理器芯片、存储芯片、模拟芯片和互联芯片等多类芯片产品，应用领域涉及消费、汽车、工业、医疗等多种市场，不同的产品和市场应用领域有着不同的竞争厂商，其中存储芯片领域国内外同行业公司有英飞凌、华邦、美光、三星、海力士等；模拟与互联芯片领域国内外同行业公司有 TI、英飞凌、迈来芯、高通等；处理器芯片领域国内外同行业公司有联咏科技、国科微、星辰科技、富瀚微等芯片企业。

#### (5) 公司发展战略及经营计划

公司坚持“计算+存储+模拟”的产品战略和全球化发展的市场战略，不断积累计算技术、AI 相关技术、存储器技术、模拟技术和互联技术等自主研发的核心技术，持续提升核心领域的技术水平；同时把公司在计算和 AI 领域的优势与存储器和模拟领域的强大竞争力相结合，积极布局与拓展汽车电子、工业、医疗、安防监控、智能物联网等重点应用领域，使公司在综合实力、行业地位和核心竞争力等方面得到有效强化，将公司打造成国内领先、具有国际竞争力的集成电路设计企业。

综合考虑当前经济和全球市场形势，结合公司实际经营情况，公司制定了 2024 年度经营计划，具体请参阅公司《2023 年年度报告》“十一、公司未来发展的展望”之“2、2024 年经营计划”。

#### (6) 重要新产品开发情况以及对公司可能的影响

报告期内，公司各产品线均进行了不同数量的新产品研发，根据不同产品的进度情况，部分新产品仍在研发阶段，部分新产品完成了投片并正在进行工程样品的生产，部分新产品已完成工程样品的生产并根据测试结果展开了量产方面的工作。新产品的陆续推出，将有助于公司在各个市场领域中产品竞争力的持续提升和公司的市场推广，从而有助于公司业务的持续稳定发展。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	12,742,026,939.41	12,421,836,630.57	2.58%	11,335,026,226.16
归属于上市公司股东的净资产	11,791,223,913.71	11,223,011,657.37	5.06%	10,300,719,539.47
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	4,530,925,656.37	5,411,867,514.79	-16.28%	5,274,059,129.97

归属于上市公司股东的净利润	537,254,388.07	789,243,560.04	-31.93%	926,181,170.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	491,438,067.99	747,218,169.59	-34.23%	894,351,810.54
经营活动产生的现金流量净额	558,151,743.82	-75,509,317.61	839.18%	1,083,239,206.06
基本每股收益（元/股）	1.1156	1.6389	-31.93%	1.9705
稀释每股收益（元/股）	1.1156	1.6389	-31.93%	1.9705
加权平均净资产收益率	4.67%	7.33%	-2.66%	10.63%

## (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,069,146,900.89	1,152,164,406.03	1,198,585,637.15	1,111,028,712.30
归属于上市公司股东的净利润	114,665,230.84	107,489,824.02	146,264,708.58	168,834,624.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	110,526,322.85	95,478,125.57	140,554,613.97	144,879,005.60
经营活动产生的现金流量净额	-38,260,270.69	274,798,939.16	166,037,027.46	155,576,047.89

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是  否

## 4、股本及股东情况

## (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	64,449	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	74,515	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
北京屹唐盛芯半导体产业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	12.57%	60,546,704.00	0.00	不适用	0.00			

上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.06%	43,622,171.00	0.00	不适用	0.00
刘强	境内自然人	8.40%	40,475,544.00	30,356,658.00	不适用	0.00
绍兴韦豪企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	24,078,487.00	0.00	不适用	0.00
李杰	境内自然人	3.89%	18,717,785.00	16,687,292.00	质押	5,200,000.00
中国工商银行股份有限公司—诺安成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.45%	16,636,721.00	0.00	不适用	0.00
上海双创投资管理有限公司—上海集岑企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.31%	15,942,972.00	0.00	不适用	0.00
洗永辉	境内自然人	2.06%	9,936,359.00	8,155,244.00	不适用	0.00
张紧	境内自然人	1.94%	9,325,685.00	7,253,764.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.61%	7,739,979.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东刘强先生和李杰先生为一致行动人；除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

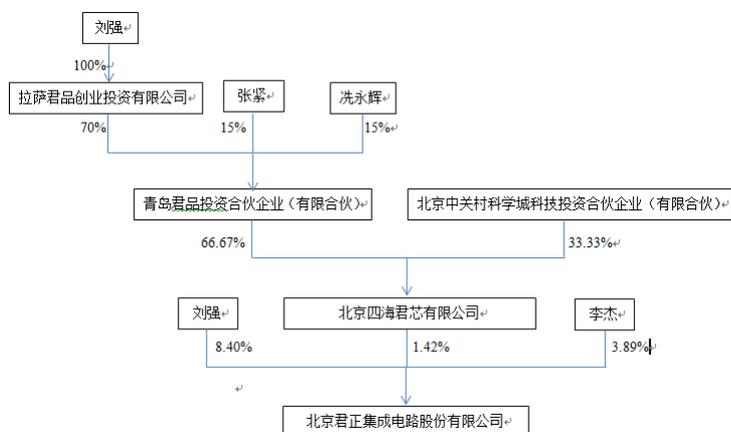
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

## (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

## 三、重要事项

无。

北京君正集成电路股份有限公司

法定代表人：刘强

二〇二四年四月十一日